

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和4年3月29日(2022.3.29)

【公開番号】特開2021-27279(P2021-27279A)

【公開日】令和3年2月22日(2021.2.22)

【年通号数】公開・登録公報2021-009

【出願番号】特願2019-146311(P2019-146311)

【国際特許分類】

H 05 K 3/46(2006.01)

10

H 05 K 3/00(2006.01)

H 01 L 23/12(2006.01)

【F I】

H 05 K 3/46 Q

H 05 K 3/00 X

H 01 L 23/12 501 P

H 01 L 23/12 B

【手続補正書】

【提出日】令和4年3月17日(2022.3.17)

20

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0077

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0077】

積層構造200は、良品エリア141及び不良品エリア142を備え配線層170を含む配線構造180と、配線構造180の上面に形成された絶縁層70とを有する。良品エリア141において、絶縁層70を厚さ方向に貫通する開口部100が形成され、不良品エリア142において、絶縁層70を厚さ方向に貫通する環状の溝150が形成されている。積層構造200は、更に、良品エリア141において、開口部100内に、開口部100の壁面100Aとの間に環状の隙間をあけて搭載された電子部品110と、不良品エリア142において、溝150の内側に位置する絶縁部材70Zと、この隙間及び溝150を充填し、絶縁層70と電子部品110と絶縁部材70Zとを被覆する絶縁層80と、絶縁層80の上面に形成され、配線層170に電気的に接続された配線層90と、を有する。

30

【手続補正2】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図1

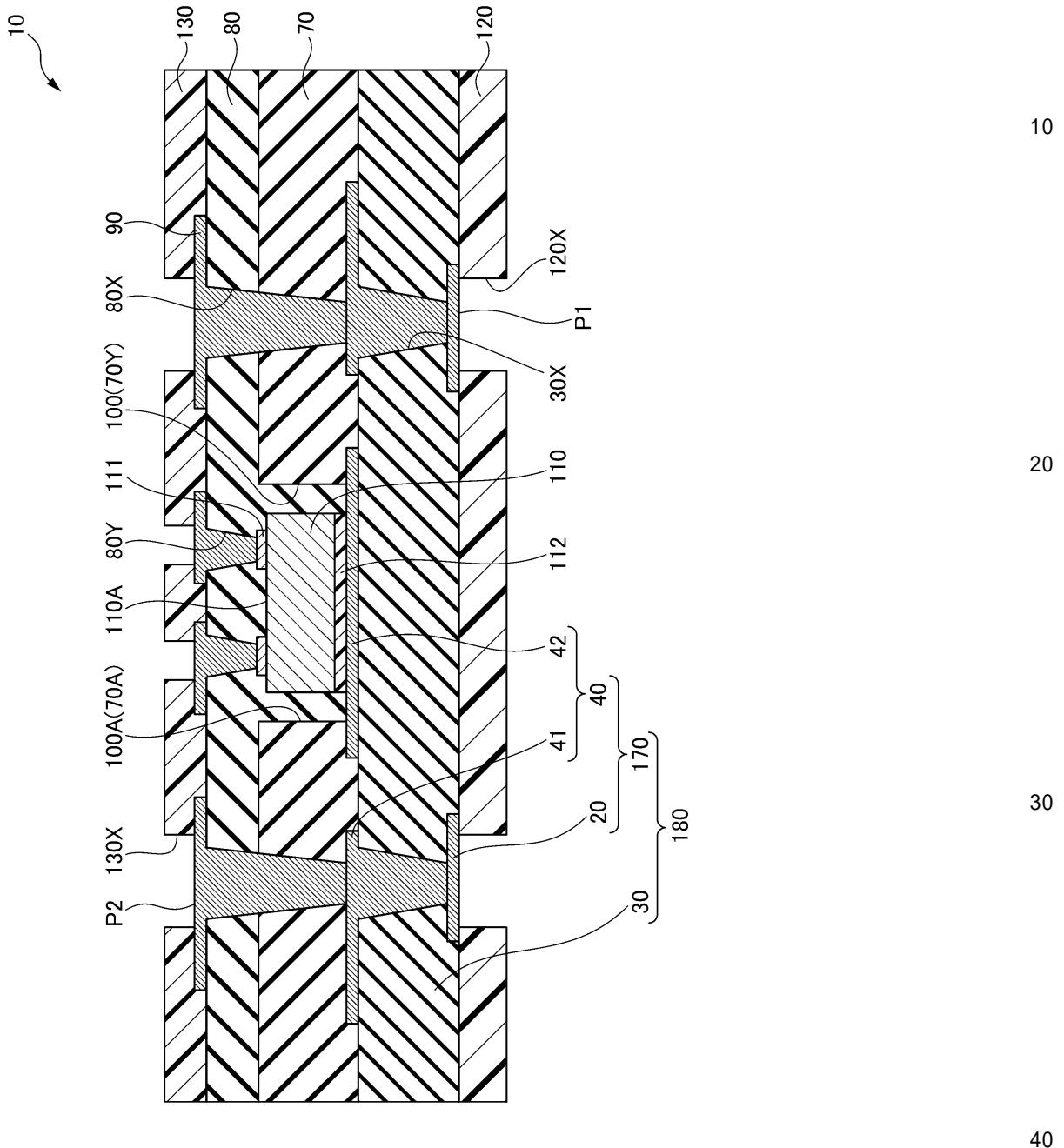
【補正方法】変更

【補正の内容】

40

【図1】

実施形態により製造する配線基板の構造を示す断面図



【手続補正3】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図1 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図16】

実施形態の変形例により製造する配線基板の構造を示す断面図

